

EU 연구혁신 주간 동향 보고

<23.04.19 한-EU연구협력센터>

○ EU, 반도체칩법(Chips Act)에 대한 정치적 합의 도달(4.18)

- 칩법은 반도체의 연구개발 및 제조를 위해 430억 유로를 동원하여 EU의 글로벌 반도체 시장 점유율을 20%(즉, 2배)로 높이는 것을 목표로 함
- 칩법은 ①Chips for Europe 이니셔티브, ②공급망 안보, ③모니터링 및 대비 시스템 구축 등 세 가지 필라(Pillar)를 가짐

※ 특히 필라1은 호라이즌 유럽 하의 연구혁신을 위한 민관 파트너십인 ‘칩 공동사업단(Chips JU)’을 통해 ‘27년까지 33억 유로를 투자할 예정

- 유럽의회와 EU 이사회의 타협안의 주요 내용으로는 ▲필라1의 칩 공동사업단(Chips JU)의 역량 강화, ▲필라2의 ‘최초 설비(First-of-a-kind Facility)’의 범위 확장* 등이 있음

* 이번 타협안은 반도체 제조에 사용되는 장비를 생산하는 설비를 ‘최초 설비’에 포함하도록 그 범위를 확장함 (역내 공급 안보에 기여하는 ‘최초 설비’는 신속한 허가 승인 혜택을 받을 수 있음)

- 더하여 이번 타협안은 반도체 생태계 조성을 위한 두 가지 핵심 요소로 국제 협력과 지적재산권 보호의 중요성을 강조함

- 한편, '22년 11월에 체결된 한-EU 디지털 파트너십은 양측이 반도체 분야에서 조기 경보 체계 구축 등을 통해 글로벌 공급망 격차 및 잠재적 공급망 차질 파악에 협력할 것과 관련 산업 정책 정보 공유 및 관련 당국 간 수출통제 조정의 가능성을 모색하기 위해 협력할 것임을 명시함

- 또한, 한-EU 디지털 파트너십은 양측이 공동사업단(JU) 등을 통해 추가적 협동 연구 활동을 수행하도록 기회를 제공할 수 있음

○ 집행위, 중국과의 민감한 과학기술 관계 다루는 새로운 규정집 마련 예정(4.18)

- EU는 중국과의 과학적 유대 관계를 단절하지 않는 동시에 민감한 기술이 중국에 유출되지 않도록 하기 위한 방법을 모색하고 있음
- 이에 따라 집행위는 EU 기업들을 위한 지침과 조치를 마련할 예정